DEUTSCHES REICH



AUSGEGEBEN AM 2. AUGUST 1933

REICHSPATENTAMT

PATENTSCHRIFT

No 581748

KLASSE 49h GRUPPE 26

K 124640 I|49h

Tag der Bekanntmachung über die Erteilung des Patents: 13. Juli 1933

Fried. Krupp Akt.-Ges. in Essen*)

Kupferlot zum Löten von gesinterten oder erschmolzenen, gegebenenfalls hilfsmetallhaltigen Karbid-, Nitrid-, Silizid- und Boridlegierungen

Patentiert im Deutschen Reiche vom 12. März 1932 ab

Bekanntlich werden aus Karbid-, Nitrid-, Silizid- oder Boridlegierungen bestehende, gegebenenfalls hilfsmetall-, z. B. kobalthaltige Hartmetalle in der Weise für Werk-5 zeuge und Arbeitsgeräte nutzbar gemacht, daß z.B. auf einen Werkzeughalter aus Stahl ein Hartmetallplättchen aufgelötet wird. Die mit solchen Hartmetallwerkzeugen erzielbaren hohen Leistungen sind nur 10 möglich, wenn die durch Lötung hergestellte starre Verbindung zwischen Hartmetall und Halter insbesondere bei der im Betrieb sich einstellenden hohen Erwärmung noch eine auch bei großen Schnittdrucken genügende 15 Festigkeit aufweist und keine Spannungsrisse im Hartmetall hervorruft. Den geforderten Bedingungen entspricht in weitgehendem Maße das bisher übliche Lötkupfer.

Es wurde nun ermittelt, daß die Hartmetallötungen für Werkzeuge und Arbeitsgeräte in ihren Eigenschaften noch wesentlich verbessert werden können, wenn man als Lot Kupfer oder eine Kupferlegierung verwendet, die o,r bis 10% Aluminium oder Mangan einzeln oder gemischt enthalten. Als

Mangan einzeln oder gemischt enthalten. Als besonders zweckmäßig haben sich dabei

Aluminium- oder Mangangehalte erwiesen, die zwischen 0,5 und 3 % liegen. So ergibt z. B. eine Hartmetallösung mit 2% Aluminium oder Mangan enthaltendem Kupfer eine Festigkeit, die um mehr als das Doppelte größer ist als die Festigkeit, die sich bei Verwendung von Elektrolytkupfer als Lot erzielen läßt. Die Gefahr des Auftretens von 35 Spannungsrissen im Hartmetall wird bei der Verwendung des in den angegebenen Grenzen Aluminium oder Mangan enthaltenden Lötkupfers trotz der höheren Festigkeit der Lötung nicht vergrößert. Ferner weist das 40 hier in Rede stehende Lot wegen seines Aluminium- oder Mangangehalts einen Schmelzpunkt auf, der unterhalb dem des Kupfers liegt, so daß bei seiner Anwendung wegen des erniedrigten Schmelzpunktes wäh- 45 rend der Lötung eine Rekristallisation des Schaftwerkstoffes, die eine Kornvergröberung und damit eine Festigkeitsverminderung im Gefolge hat, weitgehender vermieden wird als bei dem Gebrauch von Lötkupfer. Das ange- 50 gebene Hartmetallot kann auch als Zwischenlage Verwendung finden, wenn das Hartmetall z. B. aufgeschweißt oder durch Heißpressen mit dem Halter verbunden wird.

*) Von dem Patentsucher ist als der Ersinder angegeben worden:

Dr. Josef Hinnüber in Essen.

PATENTANSPRÜCHE:

1. Die Verwendung eines 0,1 bis 10 % Aluminium oder Mangan einzeln oder gemischt enthaltenden Kupferlots zum Löten von gesinterten oder erschmolzenen, gegebenenfalls hilfsmetallhaltigen Kar-

bid-, Nitrid-, Silizid- und Boridlegierungen.

2. Die Verwendung eines 0,5 bis 3 % Aluminium oder Mangan einzeln oder gemischt enthaltenden Lotes zu dem Zwecke des Anspruchs 1.

BERLIN. GEDRUCKT IN DER REICHSDRUCKEREN